

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他			
参与单位	广发证券	国泰基金	恒越基金	诺德基金
	广发基金	杭银理财	开源证券	金恒宇投资
	华安基金	交银施罗德基金	太平洋资管	圆信永丰基金
	嘉实基金	财通资管	中信保诚基金	国华兴益保险资管
	聚鸣投资	华能贵诚信托	长安基金	南京证券
	中庚基金	财通证券	复胜资产	九方智投
	博道基金	淡水泉投资	保宁资本	同犇投资
	万家基金	中邮证券	中金公司	瀛赐基金
	国寿资产	泰康资产	弢盛资产	泾溪投资
	天弘基金	千禧年基金	东北证券	积厚资本
	富国基金	西部证券	北京金控	聚力财富
	华西证券			
活动时间	2025 年 9 月 25 日			
活动地点	网络会议			
接待人员	职 务		姓 名	
	全球市场副总裁		邵 丹	

	投资者关系总监、董事会办公室副主任	孙 远
活 动 主 要 内 容	一、公司近期经营情况介绍 公司全球市场副总裁邵丹先生向与会投资者介绍了公司 2025 年上半年的经营情况。 二、投资者交流环节 1、高性能工业级存储芯片的业务发展情况 公司在工业应用市场具有较深厚的积累，工业级存储芯片现已广泛应用于工业自动化（如伺服控制、机器人、人机交互）、数字能源（如光储充一体、逆变器）以及通信基站（如高速光模块）等领域，市场份额快速提升，现已发展成为高性能工业级 EEPROM 芯片的领先品牌，与众多全球领先的设备厂商形成了长期稳定的合作关系。同时，公司借助多年运营积累的客户基础，通过多类产品的销售协同，积极推广公司的高性能工业级 NOR Flash 芯片，进一步完善了在工业应用市场的产品布局。 2、AI 眼镜等智能终端应用展望 根据 Counterpoint 统计，2025 年上半年全球 AI 眼镜的出货量同比增长 110%，眼镜作为唯一尚未被电子产品替代的穿戴产品，如果 AI 眼镜未来能够实现在功能、续航、重量等方面的平衡，有望成为消费电子领域新的增长点。上半年公司 WLCSP EEPROM 芯片在市场主要品牌的 AI 眼镜产品中取得大规模应用，出色地满足了 AI 眼镜对于芯片的低功耗和高静电防护能力等性能指标的要求。 与此同时，公司积极把握 AI 向智能终端设备渗透发展所带来的市场发展机会，并通过内生和外延等方式，实现了基于 NORD 工艺平台的覆盖 512Kb-64Mb 容量范围的 NOR Flash 产品组合，以及基于 ETOX 工艺平台的覆盖 32Mb-512Mb 容量范围的 NOR Flash 产品储备，进一步完善了在消费电子领域的产品布局。未来公司将持续加强对产品的推广、销售及综	

合服务力度，以及时满足 AI 智能终端普及所带来的存储芯片需求。

3、公司目前专利数量和研发投入情况

公司是上海市专利工作试点企业，截至上半年，公司累计获得发明专利 58 项（其中境内发明专利 53 项、美国发明专利 5 项）、实用新型专利 23 项、集成电路布图设计登记证书 90 项、计算机软件著作权 9 项，外观设计专利 1 项，正在申请的境内发明专利 34 项、外观设计专利 1 项，建立起了完整的自主知识产权体系。上半年公司研发投入达 1.03 亿元，其中第二季度研发投入 0.62 亿元，环比增长超过 50%，为历史同期最高水平。研发人员数量较上年同期增长 32%，规模得到进一步壮大。

4、汽车级 EEPROM 的市场空间

汽车级 EEPROM 的市场空间目前尚无权威的第三方统计结果，通常认为汽车级 EEPROM 的市场规模在 4-6 亿美元。公司汽车级 EEPROM 产品 2024 年度的销售收入不足 1 亿元人民币，尚有较大提升空间。

5、汽车级 NOR Flash 的进展

公司基于在汽车电子市场的技术积累和客户资源优势，顺应下游客户同时提出的汽车级 EEPROM 芯片和汽车级 NOR Flash 芯片需求，通过提供组合产品及解决方案等方式，将汽车级 NOR Flash 芯片向应用端进行延伸，上半年公司汽车级 NOR Flash 芯片已成功搭载在多款主流品牌汽车的视觉感知和智能座舱系统中导入市场，进一步完善了在汽车电子领域的产品布局。

6、光学防抖式（OIS）驱动芯片的进展

公司是全球领先的开环式音圈马达驱动芯片供应商，并基于在智能手机摄像头模组领域拥有丰富的客户资源和良好的品牌背书，持续向闭环式和光学防抖式驱动芯片等更高附加值的领域拓展。上半年公司光学防抖式（OIS）驱动芯片业务取得重要进展，多个规格型号的产品搭载在行业主要智能手机厂商的中高端机机型中实现商用，进一步优化了音圈马达驱动芯片业务的产品结构。

	7、DDR5 SPD 市场的进入壁垒与公司的市场地位 作为通用型芯片，一款合格的 DDR5 SPD 芯片不仅需要在可靠性、寿命、功耗等性能指标满足市场要求，还需要能够兼容市场上种类繁多的系统平台，芯片设计企业需要具备从芯片、应用电路到系统平台等全方位的技术底蕴，才能在行业中立足。此外，DDR5 内存模组市场高度集中，少数头部内存模组厂商占据了绝大部分的市场份额，该等厂商及生态伙伴已与供应商建立起了长期、稳定的合作关系，新进入者若缺乏为同级别客户提供产品的经验，将很难获得客户的信赖。同时，严苛的产品认证环节与漫长的验证周期也使得新进入者面临较高的商业门槛。 在内存模组配套芯片领域，公司拥有近二十年的量产经验。自 DDR2 世代起即研发并销售配套 DDR 内存模组的 SPD 芯片，凭借长期的技术积累、对行业标准的理解以及多年的产品和产业化经验，已建立了明显的技术领先优势，现已发展成为全球 DDR2/3/4/5 SPD 系列芯片的核心供应商。凭借优秀的产品性能、可靠的产品质量、完善的客户服务水平，公司及时把握住 2022 年上半年 DDR4 SPD 芯片供应短缺带来的市场机会，DDR4 SPD 芯片成功导入多家行业头部内存模组厂商，成为国内唯二具备向头部内存模组厂商直接供应配套芯片资质的企业之一。
附件清单	无